

# Sputteranlage – Co-Sputter (Selbstbau)

## Aufgabe

Herstellung von Dünnschichten in Co-Sputter Prozessen; Funktionsschichten:  
Me:a-C, und andere

## Technische Daten

- Einkammersystem
- 3 x 2“ DC- und  
3 x 2“ Magnetron-Targets
- Homogene Beschichtung von 4“  
Wafern möglich ( $\pm 5\%$ )
- Rotierender Substratteller mit  
Heizung ( $T_{\max} = 350\text{ °C}$ )
- Typische Materialsysteme:  
Ni:a-C, Ag:a-C, Cu:a-C, Pt:a-C,  
FeNi:a-C, Pd:a-C, Pt:Al, Pt:Zr:a-C,  
Pt:Rh:a-C, und weitere

## Funktionsweise

### Targetanordnung

